

セラミックコンデンサ

CeraLink™シリーズのラインアップ拡大

2016年11月8日

TDK株式会社（社長：石黒 成直）は、EPCOSブランドのPLZTセラミック（チタン酸ジルコン酸ランタン鉛）ベースのCeraLink™コンデンサのラインアップ拡大を発表します。SMD ソルダリング用（表面実装型）の低背型（ロープロファイル：LP）タイプは、500Vで1 μF あるいは700Vで0.5 μF の定格電圧と静電容量に対応した仕様となりました。これらのコンデンサは、極めて高い容積効率とコンパクトさが特徴となっています。例えば、L型端子の付いたタイプの寸法は10.84 mm x 7.85 mm x 4 mmです。コンパクトさと最高許容温度が150℃という仕様のため、これらの新型コンデンサは例えばSiCモジュールにスナバコンデンサとして直接埋め込むことが可能となっています。

J型端子の新タイプはさらにコンパクトな設計となっており、寸法はわずか7.14 mm x 7.85 mm x 4 mmです。CeraLinkのLPタイプで大きな利点として挙げられるのは、わずか2.5 nHというその極めて低いESLです。

CeraLink ソルダピン（SP）タイプは、500Vと700Vの定格電圧でそれぞれ20 μF と10 μF という高い静電容量仕様になっています。このタイプのESL値は、わずか3.5 nHという非常に低いレベルです。

CeraLink コンデンサは、寄生インダクタンスが低いため、GaNやSiCといった高速スイッチング半導体に基づくコンバータに適合します。スイッチングの際の電圧オーバーシュートとリングングは、通常のコンデンサ技術よりも大幅に低くなっています。サイズ、許容電流、耐温性（耐熱性）といった面での厳しい要求に対しても、CeraLink コンデンサなら容易に対応することができます。

主な用途

- 高速スイッチングコンバータ

主な特徴

- 500 V と 700 V の電圧仕様タイプをラインアップ
- 低い寄生インダクタンス

TDK 株式会社について

TDK 株式会社（本社：東京）は、各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で 1935 年に設立されました。

主な製品としては、各種受動部品※（製品ブランドとしては TDK、EPCOS）をはじめ、電源、HDD ヘッドやマグネットなどの磁気応用製品、そしてエナジーデバイスやフラッシュメモリ応用デバイス等があります。アジア、ヨーロッパ、北米、南米に設計、製造、販売のネットワークを有し、現在、情報通信機器、コンシューマー製品、自動車、産業電子機器の分野において、電子部品のリーディングカンパニーを目指しビジネスを展開しています。

2016 年 3 月期の売上は約 1 兆 1500 億円で、従業員総数は全世界で約 92,000 人です。

※主な製品は、コンデンサ（積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ）、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、センサ、ピエゾおよび保護部品等です。

本文および関連する画像は www.epcos.co.jp/pressreleases からダウンロードできます。

製品の詳細情報は www.epcos.co.jp/ceralink で参照できます。

お問合せは marketing.communications@epcos.com までお送りください。

報道関係者の問い合わせ先

担当者	所属	電話番号	Email Address
手島	TDK 株式会社 広報グループ	+81 3 6852-7102	pr@jp.tdk.com